

# 《第四届航空/航天焊接技术及结构完整性学术会议》第一轮通知

本届完整性会议以**航空/航天结构焊接及评估技术新发展**为主题,内容同时涉及焊接及焊接结构完整性评估新方法、新技术等方面的交流和研讨,内容主要包括:

- ◆ 航空/航天新材料、新结构焊接技术
- ◆ 航空/航天材料绿色焊接技术
- ◆ 新型焊接材料及应用
- ◆ 航空/航天焊接结构失效分析与仿真
- ◆ 航空/航天结构的先进制造技术及完整性评估
- ◆ 航空/航天结构焊接性能评价技术

## 一、组织机构

主办单位:特种焊接技术创新中心

航空焊接与连接技术航空科技重点实验室

协办单位:中国航天科工集团焊接工艺中心

北京市摩擦焊接工艺与装备工程技术研究中心

中国航天科技集团第八研究院特种焊接工艺技术中心

承办单位:中国航空制造技术研究院

上海航天设备制造总厂有限公司

北京星航机电装备有限公司

北京景辉会展服务有限公司

支持媒体:《航空制造技术》、《材料导报》、《International Journal of Lightweight Materials and Manufacture》

## 二、时间及地点

2023年11月,厦门

## 三、日程安排

2023年11月22日 会议报到

2023年11月23日 会议报告及研讨

2023年11月24日 会议结束

## 四、会议报告情况

会议拟邀请航空/航天相关领域著名院士、技术专家、教授等进行会议报告,具体内容请关注第二轮会议通知。

## 五、会议费用

一般参会:1200元/人

学生代表:800元/人

诚邀全国各科研院所、高校及企业的科技工作者积极参会,踊跃投稿,优秀稿件将推荐至《航空制造技术》、《材料导报》及《International Journal of Lightweight Materials and Manufacture》期刊。

## 六、会务联系人

柴禄 15652416766 陶军 13718580005 刘颖 13718858529

杨朝曦 17718131531 于佳男 18601271004

## 七、参会回执

欢迎扫码填写参会回执



《第四届航空/航天焊接技术及结构完整性学术会议》会务组

2023.09.08